证券代码：688362 证券简称：甬矽电子

**甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  ☑其他 （电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件《参会人员名单》 |
| 时间 | 2024年10月29日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、CTO徐玉鹏先生；副总经理、财务总监金良凯先生；副总经理、董事会秘书李大林先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.公司领导介绍一下三季报经营情况？**  2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升。得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，公司营业收入规模持续保持快速增长，2024年1-9月实现营业收入25.52亿元，同比增长56.43%，其中第三季度公司实现营业收入9.22亿元，同比增长42.22%。同时，随着公司营业收入的增长，规模效应逐步显现，毛利率有所回升，前三季度整体毛利率达到17.48%，同比增加3.41个百分点，实现归属于上市公司股东的净利润4,240.12万元，同比增加1.62亿元；公司经营活动产生的现金流超过12亿元，同比增长超180%，保持十分健康的态势。公司在先进封装等领域持续加大投入，今年前三季度公司研发投入已经超过6,000万，占营收比例达到6.58%，相较于去年同期有所增加。  **2.Q3毛利率相比Q2有所下滑，是受什么影响？未来毛利变化趋势?未来提升毛利的规划和稳态毛利目标？**  主要是前期投入的设备在三季度转固，使得当期折旧增加，营收规模环比增幅低于转固速度，对毛利有一定影响。  展望后续，第四季度营收仍然维持环比上涨的趋势，会对冲这部分折旧产生的负面影响。  公司目前在全额口径折旧的影响下仍然能保持行业内较为领先的毛利率水平，随着营收规模的扩大和产能爬坡，公司期待的稳态毛利率在25%~30%，与公司目前的产品结构规划相匹配。  **3.公司的转固政策？**  公司严格按照会计准则，在设备达到可使用状态时进行转固。  **4.未来资本开支规划？公司二期还要投四五十亿，资金来源的情况？**  公司未来两年仍会持续投入，主要集中在先进封装领域，包括倒装、RDL、2.5D封装及公司其他在研项目；但整体而言，新增对总资产的边际影响会逐步减小。  公司已公告12亿的再融资计划。除此之外，公司的现金流良好，今年三季报经营活动现金流净额已超12亿元  **5..公司的多维异构募投项目目前有没有客户和订单？我们自身技术有没有新的进展？**  公司目前在RDL和2.5D方面的布局目前已经通线，核心设备已经全部move-in，正在进行设备调试，为产品正式上线进行验证，公司也和国内的一些客户密切对接。  **6.公司目前海外客户的进展情况？**  公司从去年四季度开始，除了维持原有的国内SoC客户，积极向外扩展。海外客户方面，除中国台湾地区客户外，公司也在积极布局欧美客户，目前已经取得了一定进展。  **7.下游产品景气度的单季度表现情况？下游景气度未来的展望？PA今年四季度需求向上的原因？**  从营收角度，AIoT是公司营收占比最高的领域，接近60%，PA、安防均占比约15%，运算和车规类产品合计接近10%。第三季度，AIoT领域的客户需求十分强劲，环比第二季度的营收占比有所增加；PA表现相对一般；安防领域受限于终端客户的需求表现较为平淡。  展望第四季度，IoT领域核心客户群的需求相对旺盛，PA领域的需求也会整体回暖，会综合带动公司四季度营收环比向上。  **8.现在给客户的产品价格是稳定的吗？**  整体而言，公司产品价格相对稳定，公司坚持中高端封测的定位，会战略性放弃低毛利产品。  **9.公司Q4稼动率相比Q3会有变化吗？**  预计Q4稼动率会高于Q3。  **10.募投的多维异构项目的客户覆盖度？目前在公司产品中的占比？主做的产品类型？**  公司的募投项目涉及三类产品。Fan-out产品目前已有客户进入前期打样阶段，适用于激光雷达、毫米波雷达、消费类AI产品等，此类产品进展会更快；RDL方案不含interposer，成本会更低，应用领域相对广泛；最后一个方案是针对大芯片产品，主要面向国内的运算类客户及服务器主芯片客户等。  公司相关产品产线尚处于通线验证阶段，目前还没有实质性的营收贡献和营收占比。  **11.为了应对先进封装领域的竞争，公司对研发人员和研发费用有没有规划？公司研发费用的投入会集中于什么方向？**  公司会持续保持相对高强度的研发投入，研发费用率会维持在6%左右。研发投入的重点仍然是先进封装。目前先进封装占比较低，公司希望未来的产品结构是成熟封装和先进封装各占一半，因此公司的研发资源会向先进封装倾斜。  **12.台湾客户份额不断上涨是对其他供应商替代的结果？对台湾客户的产品的后续价格趋势怎么看？**  基于各种因素影响，部分客户似乎存在倾向将供应商方案调整成local-for-local模式，会策略性选择本地供应链。  从价格角度，公司比台湾地区的友商在技术能力持平的情况下更具备价格竞争优势，方便客户控制成本；另一方面，公司对台湾客户的营收持续扩大，对产品毛利产生正向影响。  **13.订单能见度有变化吗？未来的情况预测？**  公司的Forecast一直都是n+3，即未来三个月的预测。  **14.本次三季报营收的增长来源？是国内客户还是国外客户带来的提升？今年四季度到明年对海外需求有什么展望？**  公司营收上升得益于两个方面，一方面是国内核心客户市场表现优异，公司作为其核心供应商，伴随客户一起成长；另一方面是海外客户拓展进展十分顺利，其贡献的营收也呈现逐季增长的态势。  公司预计明年仍然会保持相对快速的增长，一方面公司会持续深化国内平台性客户，通过原有产品线优势逐步获取平台客户的更大份额；另一方面，公司还会持续扩大在外两家大客户的份额；除此之外，公司还在积极扩展欧美客户，特别是欧洲客户。  **15.公司在做2.5D封装，后续会兼顾HBM配套需求吗？**  公司正在调试的2.5D生产线与HBM的设备和工艺路线通用；是否参与HBM封装取决于公司和存储公司在商业模式上的契机。  **16.公司的海外客户主要是什么应用领域的？在做欧洲客户时候会涉及到跟国内友商的存量竞争吗？**  公司海外客户不局限于IoT领域，也包括车规、高端PMIC产品等，公司的产品线十分齐全，可根据客户的需求提供定制化服务。竞争始终存在，无论是与海外OSAT还是国内。  **17.封测行业对SiP产能的看法？是供需平衡的状态吗？不同公司SiP毛利率区间跨度比较大的原因是什么？**  国内供需关系不可一概而论，目前公司客户需求旺盛，公司稼动率也维持较高水平。总而言之，中高端产品不容易产能过剩。  毛利率跨度大是因为SiP是一个广义概念，虽然技术原理相似，但本身应用领域以及技术难度的跨度很大；另一方面也有可能是财务核算和BOM成本的口径不同。  **18.怎么看目前封测行业的竞争格局？**  随着封装技术的发展和政府补贴的退坡，行业进入壁垒会逐步增高，行业内也将优胜劣汰。  **19.公司毛利高于友商的原因？**  一方面公司产品结构优异，坚持做技术难度大、毛利率高的产品。另一方面，公司制度科学、管理层经验丰富，在效率、成本、良率上具备优势，因此能在折旧规模巨大的情况下维持行业内较高的毛利水平。  **20.公司新产线的产能情况？**  先进封装的产能爬坡速度取决于验证阶段和量产阶段，先进封装成本高昂，因此对良率的工程验证较为严谨，而量产阶段则取决于客户的需求。 |
| 附件清单（如有） | 《参会人员名单》 |
| 日期 | 2024年10月29日 |